

真空ソルダリングシステム

Model: MPXシリーズ 仕様

仕様	MPXシリーズ
チャンバ数	1~4チャンバ(加熱&冷却)
装置サイズ	約W4300 x D1350 x H1850 (MPX3)
処理スペース	W440 x D300 xH100
加熱方式	IRヒーター 加熱温度 MAX.400°C
冷却方式	水冷プレート
真空ポンプ	耐食型ドライポンプ 真空到達度 20Pa以下
排気処理	ギ酸分解処理ユニット搭載

Vacuum Reflow Soldering System

Model: MPX series Specification

Specification	MPX series
Number of chamber	1~4 (Heating & Cooling)
Dimensions (mm)	W4300 x D1350 x H1850 (MPX3)
Process area (mm)	W440 x D300 xH100
Heating	IR heaters Temperature up to 400°C
Cooling	Water-cooled plate
Vacuum pump	Corrosion-proof type dry pump 20Pa or less
Exhaust treatment	Formic acid decomposition unit